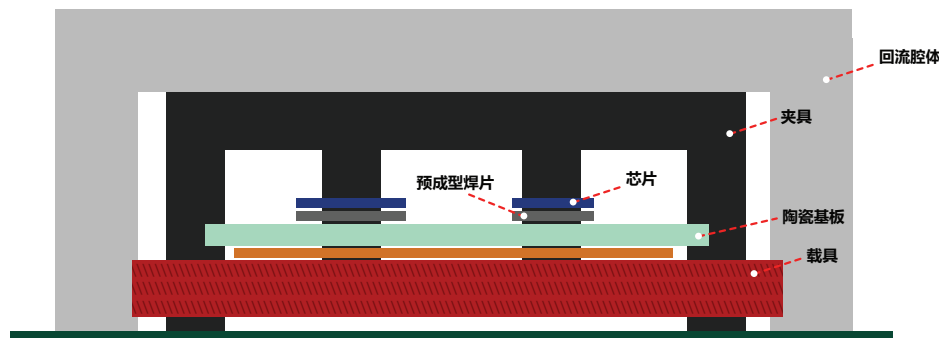


功率模块封装解决方案

挑战： 功率模块封装夹具

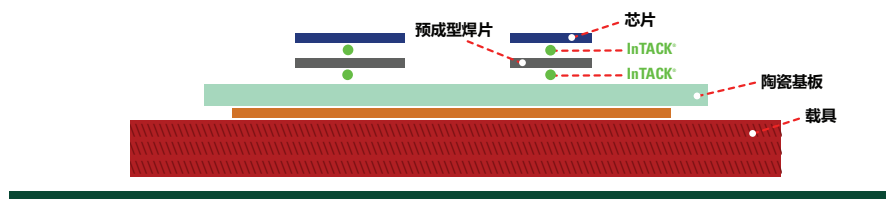


高精度贴装是长期可靠性和高一致性质量控制的保证

定制夹具的设计及维护成本昂贵，并增加回流工艺的复杂性

预成型焊片贴装 > 芯片贴装 > 夹具固定 > 搬运 > 焊接夹具固定 > 回流 > 搬运

解决方案： InTACK® 技术



无需工装夹具

简化回流工艺

减少回流时间

减少整体
作业时间

高粘力材料使芯片、焊片在贴装和回流期间保持在原来的位置

InTACK® 点胶

预成型焊片贴装

芯片贴装

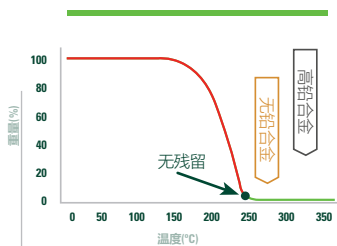
搬运

回流

搬运

回流后无残留

无助焊剂焊接和烧结应用的理想选择



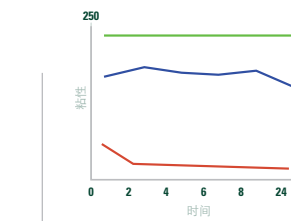
残留分析

随着时间的推移始终如一的高粘性强度

InTACK®

焊锡膏

异丙醇



高粘性且作用时间长

优点：

- ✓ 确保预成型焊片和芯片高精度贴装
- ✓ 粘力强和效果持久
- ✓ 在甲酸/真空回流效果最佳
- ✓ 对焊料润湿、空洞无影响
- ✓ 无需清洗或其它后续处理
- ✓ 通过点胶及工艺验证

InTACK™ 技术专为功率模块封装无助焊剂焊接、无残留的高质量焊接性能而设计。

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2025 钢泰公司

表格编号：99999 (SC A4) R1

